

# ウエハ用硫酸銅めっき添加剤

Additives for Acid Copper Plating for Wafer

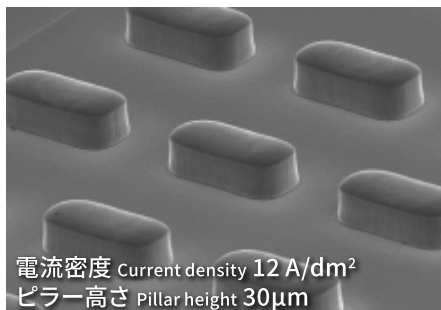
# トップルチナCP/SV/SD

## TOP LUCINA CP/SV/SD

銅バンプ形成用  
For copper bump formation

### トップルチナCP TOP LUCINA CP

- 高電流密度対応(8~12A/dm<sup>2</sup>)  
Applicable to 8 to 12A/dm<sup>2</sup> for high current density
- 良好なパターン形状を実現  
Good patterning shape can be obtained

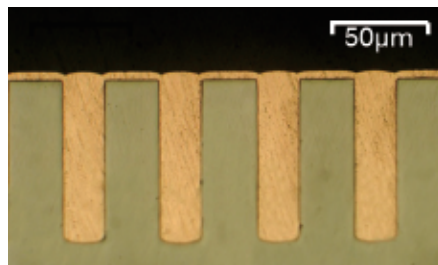


フリップチップ実装用途だけでなく、銅ピラーの高速形成にも対応  
For flip-chip mounting and high-speed copper pillar formation

TSVフィリング用  
For TSV filling

### トップルチナSV TOP LUCINA SV

- 高アスペクト比ビアのフィリングが可能  
Via-filling for high aspect ratio can be realized

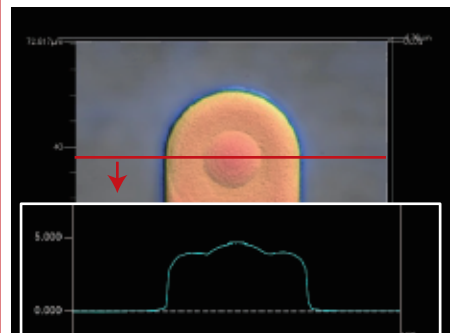


TSV形成用途だけでなく、高アスペクト比トレンチへの埋め込みにも対応  
For TSV formation and high-aspect-ratio trench filling

低アスペクト比ビアおよびトレンチフィリング用  
For low aspect ratio via-, trench-filling

### トップルチナSD TOP LUCINA SD

- ブラインドビアホール、トレンチの埋め込み性に優れる  
Excellent performance in blind via-, trench-filling

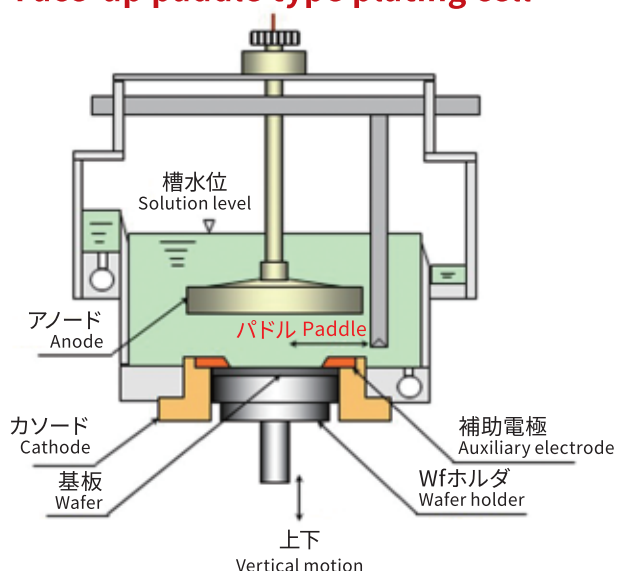


トップルチナCP/SV/SDは、全ての添加剤成分の定量分析が可能  
Quantitative analysis is possible for all additives

## サポート体制 Support system

フェイスアップ式めっき装置で4~8インチの試作試験が可能 (12インチ以上はご相談となります)  
Prototype test for 4 to 8 inches of wafer can be performed by using the face-up paddle type plating system. (Please consult with us if wafer is 12 inches or more.)

### Face-up paddle type plating cell



株式会社東設製 フェイスアップ式半自動めっき装置  
Face-up paddle type plating system made by Tosetz